公司代码:688652　　公司简称:京仪装备

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第11次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为147,925,398.65元,母公司实现的净利润为126,104,438.14元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本168,000,000.00股,以此计算合计拟派发现金红利21,000,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为14.20%。

2. 本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	京仪装备	688652	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓帅男	安宁
联系地址	北京市北京经济技术开发区亦庄河二街8号院14号楼A座	北京市北京经济技术开发区亦庄河二街8号院14号楼A座
电话	010-58917226	010-58917226
传真	010-58917219	010-58917219
电子信箱	zhengquanshiwubo@baoctltd.com.cn	zhengquanshiwubo@baoctltd.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,主营产品包括半导体专用温控设备(Chiller)、半导体专用工艺废气处理设备(LocalScrubber)和晶圆传片设备(Sorter)。公司自成立以来,主营业务未发生重大变化。

公司产品主要包括半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备,具体如下:

公司产品主要应用于成熟或先进制程集成电路制造的集成电路制造产线。在逻辑芯片领域,28nm以下为业内先进制程,公司产品已经适配国内最先进的逻辑芯片制造产线;在3DNAND存储芯片领域,128层以上(含128层)为业内先进制程,公司产品已经适配国内最先进的存储芯片制造产线。

2.2主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售业务,通过向下游半导体领域公司销售半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备等产品实现收入和利润。报告期内,公司主营业务收入主要来源于半导体专用设备产品的销售。

2、采购模式

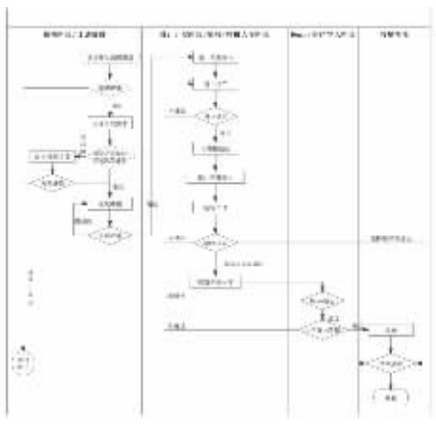
公司采购的原材料种类繁多,主要类别包括电器装置类、电气元件类、机械标准件类、机械加工件类、化学制品类、仪器仪表类等,其中,部分电器装置类零部件及机械加工件等核心零部件由供应商依据公司提供的图纸自行采购原材料并完成定制加工后向公司供应。

为加强对供应商的管理及筛选,公司采购中心会同品质中心、研发中心及运营效率中心下属的生产部等相关部门对供应商进行遴选和评估,考察供应商的资质实力、产品质量情况、供货及时性等方面,经审核通过后确定合格供应商名录,并跟踪考核进行持续更新。目前,公司已与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。

公司通过与供应商签署采购合同的方式开展采购业务。采购部根据生产、研发等部门提交并经公司批准采购信息文件(如采购申请单等),综合考虑公司现有生产安排、销售订单、原材料库存、研发需求等情况安排采购计划,按要求在合格供应商名录中选择供应商并进行询价、比价,确定最终合格供方后进行采购。采购物资送达后,品质中心进行到货检验,检验合格后由采购中心及生产部办理入库手续,完成采购。

3、研发模式

公司主要采用自主研发模式,逐步取得了半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备、晶圆传片设备系列重要研发成果。公司遵循行业惯用研发模式,产品研发流程严格按照公司设计的研发流程执行。公司研发流程主要包括预研阶段、设计开发需求输入、计划阶段、设计开发阶段、验收阶段、研发样机入库阶段、客户端验证(Demo)、生产导入阶段、收尾阶段。新品设计开发流程图如下:



(1)预研阶段/设计开发需求输入/计划阶段

根据市场及客户需求,公司研发中心结合产品实际应用、产品生命周期维护阶段优化等需求形成设计开发需求。设计开发负责人负责组织市场调研,同时对该领域的知识产权信息、相关文献及其他信息进行检索,分析项目的技术发展状况、知识产权状况和竞争对手状况等,保证研究投入的合理性,并将调研结果形成立项申请书。运营效率中心下属的项目管理部对立项申请书进行评审,立项评审通过后,设计开发负责人根据要求成立项目研发小组。

(2)设计开发阶段/验收/样机入库阶段

研发人员整合设计开发预研需求、设计开发需求和立项申请书,进行设计和开发。研发中心内部对设计开发进行评审,通过评审后需根据评审的技术要求制作样机,并进行样机实验和所需的可靠性实验,作为本次设计和开发的验证依据。样机完成设计研发开发后,技术负责人需对设计开发过程进行确认,生成设计开发输出请单(包括设计的评审报告、会议纪要和可靠性验证报告等)。

设计开发完成后,研发中心向项目管理部提交验收申请,由项目管理部组织验收工作,对样机进行测试与检验。完成测试检验活动后,由项目管理部组织项目验收会对涉及开发输出是否满足输入的要求进行评审,评审通过后研发样机入库。

(3)Demo/生产导入阶段/收尾阶段

验证评审通过后,由研发中心主导,生产、品质、采购等多部门开展生产导入,形成作业装配图、生产流程工序卡、产品技术规范等文件。产品达到量产总体评审后,研发中心将产品过程文件移交生产部。项目收尾阶段由项目管理部组织项目结项进行评审与项目复盘。

4、生产模式

公司销售中心汇总市场信息,并根据客户需求形成销售订单。销售订单签署后,公司销售、采购、生产部召开月度投产会议,讨论投产计划,形成投产计划并经公司批准通过后执行。公司生产部根据投产计划安排生产,按照投产物料需求领取物料,并根据装配指导和工艺文件对生产组件、半成品等进行组装和装配,品质中心对生产过程进行监督。装配完成后由生产部进行产品调试,调试合格后品质中心对产品进行检验,检验通过后完成产成品入库。

在保证核心技术安全的情况下,公司将部分组装环节交由第三方负责。第三方完成组装后,将产品交付给公司,由公司负责调试和测试。调试合格后品质中心对产品进行检验,检验通过后完成产成品入库。

公司高度重视产品质量和交付效率,根据生产进度情况不断调整优化生产过程,确保产品和服务满足客户需求。

5、销售模式

报告期内,公司采用直销模式销售产品,通过商务谈判或招投标等方式获取销售订单。直销模式可减少产品中间流通环节与成本,贴近市场并有助于及时深入了解客户需求,有利于控制产品销售风险和及时接收客户反馈,以便于更好、更迅速的服务客户。公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比高、服务优良的综合优势,及时跟进行业发展趋势,适时推出新产品以满足客户需要。公司的销售程序一般包括市场调查与推介、客户需求确认、产品报价、销售订单签署、合同执行、合同回款、产品安装调试及售后服务等步骤。

公司设有销售中心负责市场开发和产品销售,同时售后部的服务工程师在主要客户所在地驻场工作,便于及时响应客户需求,负责公司产品的安装、调试、维保、维修和技术咨询。经过多年努力,凭借优质的产品和售后服务,公司已与国内主流集成电路制造商建立了良好的合作关系。

6、公司采用目前经营模式的原因及未来变化趋势

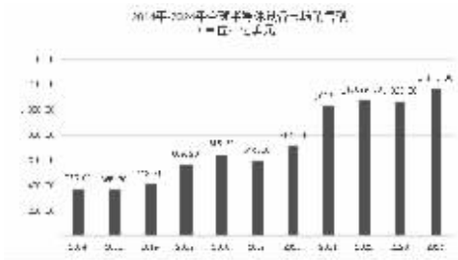
公司结合国家产业政策、上下游发展状况、市场供需情况、自身主营业务及发展阶段等因素,形成了目前的经营模式。报告期内,公司现有经营模式取得了良好的效果,业务快速发展,公司经营模式未发生重大变化,在可预见的未来亦不会发生重大变化。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)全球半导体设备市场规模波动上涨

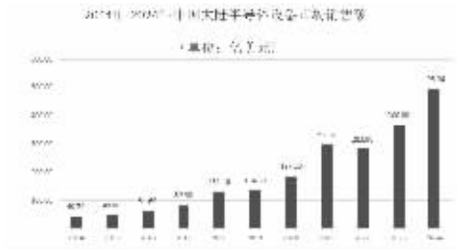
半导体设备行业与半导体行业密切相关,且市场规模波动幅度更大。长期来看,半导体行业将会保持旺盛生命力,作为产业链上游的半导体设备行业市场规模也会不断扩大。根据半导体行业内“一代设备、一代工艺、一代产品”的经验,半导体设备是半导体产业的技术先导者,芯片设计、晶圆制造和封装测试等需在设备技术允许的范围内设计和制造,设备的技术进步又反过来推动半导体产业的发展。因此半导体设备行业被视作半导体制造的基石,是半导体行业的基础和核心。据SEMI统计数据显示,2024年,全球半导体设备市场增长了10%,从2023年的略微下降中反弹,达到了1,171亿美元的年度销售额历史新高。



数据来源:SEMI

(2)我国半导体设备市场规模持续扩大

2014至2024年,中国大陆半导体设备销售额增长了452.30亿美元,年复合增长率高达24.71%。根据SEMI统计数据显示,2024年,中国大陆、韩国和中国台湾仍然是半导体设备支出的前三大市场,合计占全球市场的74%。中国大陆巩固了其作为最大半导体设备市场的地位,投资同比增长35%,达到496亿美元。



数据来源:SEMI

(3)客户验证和客户资源壁垒

半导体专用设备的技术指标、运行稳定性将对晶圆制造产线的产量、良率及稳定性产生直接决定性影响,下游晶圆制造厂商对半导体设备供应商的筛选标准较为严格。按照行业惯例,下游晶圆制造厂商要求半导体设备供应商根据客户需求提供设备进行验证,晶圆制造厂商在具体生产环境下对验证设备进行技术验证,主要是验证技术指标能否达到工艺制程要求、设备运行稳定性状况等,在此期间半导体设备供应商工作团队与晶圆制造厂商保持持续沟通,持续解决设备验证过程中出现的问题,不断完善技术细节,部分客户会将验证设备生产出的测试产品交付其下游客户进行验证。只有经过全面系统性验证流程、达到工艺制程要求后,半导体设备才能进入晶圆制造厂商的合格供应商名单,该验证周期耗时较长、需投入较大量的人力及资源。

半导体设备经过验证并实际投入晶圆制造厂商的产线后,综合考虑到前期验证投入资源、晶圆生产稳定性等因素,已通过验证的半导体设备将成为客户建设下一条晶圆制造厂线的优选设备,在未出现新的技术需求情况下该供应商不会被轻易更换。因此半导体设备企业成功通过验证并进入实际生产后,与下游晶圆厂商往往形成较为紧密合作关系,积累半导体行业客户资源。

公司自主研发的半导体专用设备已成功进入行业知名半导体制造企业,与客户建立了良好的合作关系。经过前期多次合作,公司熟悉客户验证流程及验证要求,与客户工作团队对接顺畅紧密,能够及时跟进客户最新工艺制程的要求并积极研发产品提供解决方案,公司已在半导体行业内积累形成良好的客户资源。

潜在竞争者拟进入半导体设备领域,因未取得下游晶圆制造厂商验证认可,将无法获得下游客户的订单,潜在竞争者进入半导体设备领域争取优质客户资源存在较大难度。

(4)潜在竞争者进入半导体行业存在较大的技术壁垒

半导体专用设备行业属于技术密集型行业,公司的主营产品研发和生产技术涉及物理、化学、流体、材料、机械、电气、控制、建模等多学科、多领域知识的综合运用。半导体设备领域国际巨头凭借先发优势已形成较高的市场占有率,在其优势技术领域已形成了技术壁垒并采取了知识产权保护措施。国内少数企业经过了数年的技术研发和工艺积累,在部分领域实现了技术突破和创新,成功推出满足市场需求的产品并得到下游客户批量化应用,形成了相应领域核心技术及产品竞争力,同步采取了知识产权保护措施。潜在竞争者要实现半导体行业布局,需要进行大量的研发投入和技术积累,并能够研发形成具有竞争力、得到市场认可的半导体设备。该过程需要投入较多时间、资金,面临较多知识产权保护措施的限制,很可能面临研发失败或者市场开拓失败的风险。

以公司的主营产品半导体专用温控设备为例,该设备的核心技术指标包括温控区间。随着工艺制程的发展,晶圆制造对温控设备的温控区间要求朝着超低温温控区间发展,当前包含国内外厂商在内的整体市场中能够提供超低温温控区间产品的厂家数量极少。公司创造性通过两级复叠制冷技术已能够实现-70℃超低温温控,公司在研项目正朝着提供更低温控区间方向进行研发。潜在竞争者因缺乏前期技术积累,进入该产品领域难以达到超低温的温控区间技术要求,其产品竞争力将受到限制,其研发产品也受到公司知识产权保护措施的影响,研发成功难度较大。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主营产品包括半导体专用温控设备(Chiller)、半导体专用工艺废气处理设备(LocalScrubber)和晶圆传片设备(Sorter)。半导体专用温控设备(Chiller)、半导体专用工艺废气处理设备(LocalScrubber)打破了国外厂商对相关产品的垄断,逐步实现进口替代,并已广泛用于国内主流集成电路制造产线。

(1)半导体专用温控设备

公司深耕半导体专用温控设备多年,已形成半导体温控装置制冷控制技术、半导体温控装置精密控温技术、半导体温控装置节能技术三项核心技术,并先后推出V系列、C系列、H系列等迭代产品,温控区间覆盖空载温控精度为±0.05℃,运行状态下温控精度为±0.5℃,并承担国家级重大专项课题(温控装置相关)致力于研发超低温半导体专用温控设备。公司产品主要核心功能指标与主要竞争对手竞品相比无明显差异。

公司半导体专用温控设备已打破国外厂商垄断,成为半导体专用温控设备领域内主要的国内厂商。

(2)半导体专用工艺废气处理设备

公司半导体专用工艺废气处理设备已打破国外厂商垄断,成为半导体专用工艺废气处理设备领域内主要的国内厂商。

(3)晶圆传片设备

公司进入晶圆传片设备前,该领域市场份额主要由国外厂商主导,国外厂商主要以瑞斯福公司、平田公司为代表,国内厂商市场份额占比极低。公司进入该细分领域后,逐步研发并发出三代晶圆传片设备,并从研发实验阶段逐步进入量产。

公司在晶圆传片设备领域已形成半导体晶圆传控技术、晶圆翻片技术、X-θ自动寻心算法、微晶背接触传控技术、晶圆区域检测技术五项核心技术。关于公司晶圆传片设备的核心技术情况,中科合创(北京)科技成果评价中心于2022年11月出具科学技术成果评价报告和科学技术成果评价证书,其认定晶圆传片设备整体技术达到国际先进水平。

报告期内公司晶圆传片设备销售量持续增长,市场份额逐步扩大。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)半导体下游需求保持高速增长

目前,中国是全球最主要的半导体消费市场之一和电子信息产品的重要生产基地,半导体市场需求以及工业制造优势驱动全球半导体产能逐步向中国转移。一方面,产能的持续转移将直接刺激半导体生产线投资,进而为半导体专用设备创造了巨大的市场空间;另一方面,全球产能向中国转移也促使相关生产工艺不断完善提高,促进中国半导体产业专业人才的培养以及行业配套的不断发展,半导体产业环境的持续优化也将间接带动半导体专用设备制造产业的扩张与升级。

近年来,云计算、物联网和机器人产业发展迅速,各类智能化、网络化的新型消费电子品不断涌现,上述产业已成为半导体下游需求强劲增长点。在人工智能、云计算等战略新型产业发展的推动下,半导体的需求将持续增加。

(2)半导体设备国产化是集成电路产业国产替代的核心

伴随着我国半导体终端产品消费量的急剧增长以及全球半导体产能向中国大陆转移,我国半导体产业发展迅速,进而推动了市场对半导体专用设备的需求。但是当前我国工大的半导体设备市场需求与有限的国产设备供给能力形成明显反差,半导体专用设备依然严重依赖于进口。在当前外部环境复杂多变背景下,我国半导体设备的进口受限,半导体设备进口依赖已经严重阻碍我国半导体行业的自主发展。

目前,我国半导体产业链正逐步走向成熟,在某些细分领域,半导体设备厂商已经形成一定的技术突破并形成成熟产品。从节约设备成本、提高设备性价比、实现对半导体设备的定制要求以及更高质量的售后服务的角度考虑,国产半导体设备已成为国内半导体厂商的重要选择。

(3)国家对半导体行业的政策扶持

作为信息技术产业的核心,集成电路已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志,公司所处的半导体设备行业是国家产业政策重点鼓励和扶持的行业。近年来,政府开始大力支持集成电路产业发展,先后出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》和“国家重大科技专项”等政策,明确指出集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。相关扶持政策的密集出台明确显示了政策扶持半导体产业的决心。与此同时,国家及地方集成电路产业基金纷纷设立,已实施项目覆盖设计、制造、封装测试、设备、材料、生态建设各环节。我国半导体专用设备行业迎来了前所未有的政策契机。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,794,099,725.00	4,044,557,850.71	18.28	2,860,771,455.34
归属于上市公司股东的净资产	2,201,507,799.63	2,074,288,676.11	6.13	1,933,688,508.41
营业收入	1,426,242,870.69	1,026,465,508.65	38.95	742,283,148.65
利润总额	159,197,818.34	167,767,317.85	-5.11	133,249,001.19
归属于上市公司股东的净利润	147,925,398.65	152,911,820.19	-3.26	119,135,490.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,211,757.12	115,752,020.73	-0.47	86,693,508.62
经营活动产生的现金流量净额	381,368,404.15	-293,160.98	不适用	41,089,427.79
加权平均净资产收益率(%)	6.92	7.63	减少0.71个百分点	16.70
基本每股收益(元/股)	0.88	0.91	-3.30	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.91	-3.30	0.92
研发投入占营业收入的比例(%)	9.81	9.17	增加0.64个百分点	8.29

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	337,775,516.09	396,868,973.52	368,410,348.46	323,188,032.63
归属于上市公司股东的净利润	35,878,705.93	54,125,680.38	38,506,656.71	19,415,356.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,620,979.66	43,595,589.93	34,670,071.86	5,325,115.67
经营活动产生的现金流量净额	-183,570,846.15	123,076,816.57	42,599,379.92	399,263,020.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,087
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,716
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京京仪集团有限责任公司	0	47,250,000.00	28.13	47,250,000	无	0	国有法人
安徽北自投资管理中心(有限合伙)	-5,566,058.00	20,136,418.00	11.99	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-长城人工智能主题混合型证券投资基金	3,629,652.00	3,945,431.00	2.35	0	无	0	其他
嘉兴芯存长志股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,709,488.00	2,000,512.00	1.19	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-易方达高端新兴产业股票型证券投资基金	541,950.00	1,802,609.00	1.07	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	1,699,835.00	1,699,835.00	1.01	0	无	0	其他
广西泰达新原股权投资有限公司	-3,260,000.00	1,500,000.00	0.89	0	无	0	境内非国有法人
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	-327,730.00	1,327,144.00	0.79	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	1,291,967.00	1,291,967.00	0.77	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	1,178,956.00	1,178,956.00	0.70	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

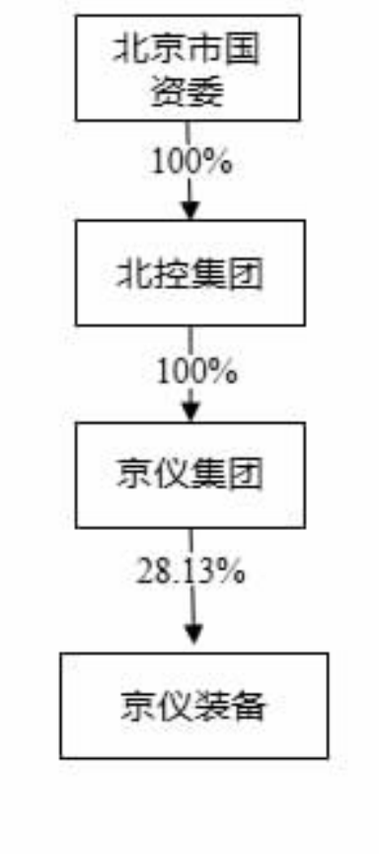
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入142,624.29万元,较上年同期增长38.95%;归属于上市公司股东的净利润为14,792.54万元,较上年同期下降3.26%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,521.18万元,较上年同期下降0.47%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688652　　证券简称:京仪装备　　公告编号:2026-008

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币1.25元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于30%,是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。
- 该利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为147,925,398.65元,母公司实现的净利润为126,104,438.14元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1. 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本168,000,000.00股,以此计算合计拟派发现金红利21,000,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为14.20%。

2. 本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体情况如下:

项目	2025年度	2024年度
现金分红总额(元)	21,000,000.00	21,000,000.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	147,925,398.65	152,911,820.19
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	329,920,544.59	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	42,000,000.00	
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0	
最近三个会计年度平均净利润(元)	150,418,609.42	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	42,000,000.00	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	否	
现金分红比例(%)	27.92	
现金分红比例(K)是否低于30%	是	
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	234,106,780.71	
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否	
最近三个会计年度累计营业收入(元)	2,452,708,379.34	
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	9.54	
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	否	
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否	

注:公司于2023年11月在上海证券交易所科创板上市,未满三个完整会计年度,根据《科创板股票上市规则》第12.9.1条“公司上市不满三个完整会计年度的,最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度”,故上表中“最近三个会计年度”系指2025年度、2024年度。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 147,925,398.65元,拟分配的现金红利总额为21,000,000元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为14.20%,低于30%,具体原因如下:

(一)行业特点及发展情况

半导体设备行业与半导体行业密切相关,且市场规模波动幅度更大。长期来看,半导体行业将会保持旺盛生命力,作为产业链上游的半导体设备行业市场规模也会不断扩大。目前全球半导体产业正向中国大陆加速转移,中国成为全球最大的集成电路生产和消费国,受益于国内晶圆厂的产能持续扩张,推动了市场对半导体专用设备的需求。

(二)公司发展阶段及自身经营模式

公司所处的半导体专用设备行业属于资金密集型,前期研发投入大,产品验证和盈利周期较长。目前公司处于快速成长阶段,且行业技术更新迭代快,公司在半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备及晶圆传片设备多个领域进行布局,并处于面板等泛半导体行业的市场开拓阶段,在研发投入、人才引进、厂房建设以及市场拓展等方面均需要大量的资金支持。

(三)盈利水平及资金需求

2025年度实现归属于上市公司股东的净利润147,925,398.65元,公司整体盈利状况稳定。

半导体专用设备行业属于技术密集型,为满足下游客户对半导体质量控制领域不断发展的产品和技术要求,公司将加大研发投入。同时,为满足客户日益增长的产能需求,公司处于持续扩产阶段。需要充足的资金以保证公司的正常运营与长远发展,保障公司的持续健康发展。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

充分考虑到公司目前处于快速发展期,结合目前经营状况及未来资金需求,需要充足的资金以保证公司的正常运营与长远发展,继而更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求。

(五)上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司2025年度未分配利润将累积滚存至下一年度,以支持公司在研发创新、产能扩充及日常运营等方面的持续发展。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,积极履行公司的利润分配政策,更好地维护全体股东的长远利益。

(六)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开,并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

(七)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,兼顾公司可持续发展、重视对投资者的合理回报,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月30日召开第二届董事会第十一次会议审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:688652　　证券简称:京仪装备　　公告编号:2026-009

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于2026年度董事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了2026年度董事薪酬方案。现将具体情况公告如下:

一、适用范围

在公司领取薪酬的董事。

二、适用期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事领取固定津贴,除此之外不再另行发放薪酬,独立董事2026年度津贴标准为每人12万元/年(含税),按月发放。

2、非独立董事薪酬方案

2026年度,在公司任职的非独立董事按照担任的高级管理岗位、与公司签署的相关合同和公司的薪酬管理制度领取薪酬。不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

四、审议情况

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年3月28日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,审议《关于公司(2026年度董事薪酬方案)的议案》,全体委员回避表决,该议案直接提交董事会审议。

(二)董事会的审议情况

公司于2026年3月30日召开第二届董事会第十一次会议,审议《关于公司(2026年度董事薪酬方案)的议案》,全体董事回避表决,该议案将直接提交2025年年度股东会审议。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:688652　　证券简称:京仪装备　　公告编号:2026-007

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2025年度(以下简称“报告期”或“本报告期”)募集资金存放与实际使用情况专项报告,说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1778号)核准,本公司获准向社会公开发行普通股(A股)4,200万股。本次发行委托国泰海通证券股份有限公司承销,发行价为每股31.95元,实际发行股份数量4,200万股。截至2023年11月24日,本公司共募集资金1,341,900,000.00元,扣除各项发行费用75,646,501.03元后,募集资金净额为1,266,253,498.97元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)以致同验字(2023)第110C000538号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日,本公司募集资金累计使用金额为人民币865,639,662.28元,其中以前年度已使用金额为人民币568,268,591.08元,本年度使用金额为人民币297,371,071.20元。

募集资金余额为人民币128,368,797.93元,募集资金现金管理金额为人民币301,000,000.00元。

募集资金基本情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年11月24日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	1,341,900,000.00
其中:超募资金金额	360,253,498.97
减:直接支付发行费用	75,646,501.03
二、募集资金净额	1,266,253,498.97
减:	
以前年度已使用金额	568,268,591.08
本年度使用金额	297,371,071.20
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	301,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他-具体说明	0.00
加:	
募集资金利息收入	28,754,961.24
其他-具体说明	0.00